I'm not a robot

序言　　作为ROG玩家国度里的纯血真旗舰,长久以来Maximus Extreme系列一直都是以其顶级的用料和丰富的配套设备存在着.随着Intel第13代酷睿的发布,搭载者最新芯片组的ROG Maximus Z790 Extreme也随之来到了我们的面前. 序言　　关注ROG主板的玩家们应该都知道,在Intel Z790芯片组推出的早期,ROG Maximus序列里缺少了Formula的身影,而且其独特的白色主板地位也被初代Z790 Apex所替代.但随着这次14代酷睿处理器的上市,没想到Z790 Formula居然重出江湖.　前言　英特尔自2021年发布12代酷睿处理器以来，就一直标榜"大小核"混合架构的优势，且随着处理器的设计进步，性能P核与效能E核也在不断变强，而超线程(技术)在某些应用场景中效果却不在明显，所以这代处理器就顺(wei)势(bei)而(zu)为(zong)的取消了超线程技术，且官称可以带来更好的执行效率和响应速率，并降低了整体功耗，优化了温度及能耗比表现。此次发布的15代酷睿处理器，命名为Ultra 200S系列，首发SKU共计5款，除了Ultra 9系以外，7和5系都有K(能超频、有核显)及KF(能超频、无核显)的SKU可选，型号/规格具体如下。 英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器 首发型号　　英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器，依旧采用混合架构(P核+E核)，并推出了分离式模块化设计；模块与模块之间相互独立，并通过基础模块的总线进行互联通信，最后再通过英特尔的Foveros 3D封装技术封装在一个Die上，较比AMD"走线"的CHiplet思路，其带宽会更高，延迟也更低。全新的Arrow Lake架构设计，大核微架构从上代的Raptor Cove升级为全新的Lion Cove，小核微架构也由Gracemont变为Skymont，IPC性能相较上代分别有了9%和32%的提升。 英特尔 Foveros 3D封装技术解析 英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器 Arrow Lake架构 英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器 IPC提升之处　　英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器的Arrow Lake架构首次采用大小核交错排列，让大核热量尽量分散，来优化解热效率。并且全核心共享三级缓存，性能核的二级缓存也由上代的每核心2MB提高到每核心3MB。处理器全新的LGA-1851接口，适配800系列芯片组主板，芯片组支持最多24条PCIe 4.0通道，CPU+芯片组的PCIe通道数可达48条。CPU有20条是PCIe 5.0速率，还集成了雷电4模块，通过主板上的外接芯片可以升级为120Gbps的雷电5接口！ 英特尔 酷睿 Ultra 200S处理器 缓存层级解析 英特尔 800系列 芯片组 I/O解析　正文　华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板，是ROG"纯血"系列中的旗舰级产品，定位于高端发烧友。其外包装还是熟悉风格，并用图文形式介绍了产品的外观/特点及技术/参数，并首次在主板上加入了超大屏幕的设计！而在包装上盖内，华硕也用图文形式介绍了其最新的"易用性"设计(M.2及显卡的易拆装方式)；配件也相当丰富，ROG最新"潮品"的全金属"信仰"瓶起子、螺丝刀、驱动U盘及VIP卡都送了，还有一大堆线缆及配件，真是面面俱到。 华硕ROG Z890 Extreme主板 外包装① 华硕ROG Z890 Extreme主板 外包装② 华硕ROG Z890 Extreme主板 内包装① 华硕ROG Z890 Extreme主板 内包装② 华硕ROG Z890 Extreme主板 配件一览① 华硕ROG Z890 Extreme主板 配件一览②　　华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板的外观，较比上代也更为简约大气，宽大的EATX规格，有着全覆盖的散热装甲及金属背板，也提升了观感和质感，并在一体化I/O盔甲上首次加入了5英寸LCD大屏幕，其支持动画及硬件信息的个性化显示。I/O接口十分丰富，包含BIOS刷新/清空按键、HDMI、2个雷电5(最高可达120Gbps)、1个USB3.2 (20Gbps)和7个USB3.2 (10Gbps)、10G/2.5G双网卡、WiFi 7&蓝牙5.4、镀金MIC IN/LINE OUT及光纤S/PDIF OUT接口；在输出扩展方面做到了极致，也完全满足了用户的使用所需。 华硕ROG Z890 Extreme主板 外观设计① 华硕ROG Z890 Extreme主板 外观设计② 华硕ROG Z890 Extreme主板 I/O接口一览 华硕ROG Z890 Extreme主板 易拆式WiFi 7天线　　华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板的板载接口极为丰富，各种物理开关加持，且USB 20Gbps/10Gbps及双USB 5Gbps共计4个板载接口，也让高端机箱面板I/O发挥了满血效能。主板有2个PCIe 5.0 x16显卡插槽、4个DDR5插槽及6个M.2 SSD接口(3个5.0——M.2_1/3/4、3个4.0——M.2_2及Q-DIMM.2扩展卡)。供电设计为24+1+2+2相，这庞大的29相供电规模已然再无敌手；加之双热管相连设计的VRM散热模块，为处理器提供了极致的供电效率。 华硕ROG Z890 Extreme主板 板载接口一览① 华硕ROG Z890 Extreme主板 板载接口一览② 华硕ROG Z890 Extreme主板 板载接口一览③ 华硕ROG Z890 Extreme主板 24+1+2+2供电设计① 华硕ROG Z890 Extreme主板 24+1+2+2供电设计② 华硕ROG Z890 Extreme主板 VRM散热模块 双热管相连　　华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板，这次最大特色当属其"易用性"方面的设计！特别是Q-DIMM.2扩展卡的固态安装方式，是完全免工具的。而板载M.2固态的安装，也有"快拆装甲、滑轨卡扣、便捷卡扣2.0"三种新设计；还有华硕一直引领业界的显卡易拆装设计，这次是更为符合人性化的设计——正常插入即固定、从显卡前端拔下即拆卸，可谓大道从简、返璞归真！主板还有一个关于内存插槽的新设计—— NITROPATH，其采用更短的金手指引脚(优化信号路径)，让DRAM与CPU之间数据传输更快，提升超频空间和稳定性；同时经重新设计的内存插槽，也能规避内存及插槽安装过程的磨损。 华硕ROG Z890 Extreme主板 M.2快拆装甲 拆装示意 华硕ROG Z890 Extreme主板 M.2快拆装甲 细节设计(热管散热栅+VC均热板) 华硕ROG Z890 Extreme主板 板载M.2接口×4 华硕ROG Z890 Extreme主板 Q-DIMM.2扩展卡 外观设计① 华硕ROG Z890 Extreme主板 Q-DIMM.2扩展卡 外观设计② 华硕ROG Z890 Extreme主板 Q-DIMM.2扩展卡 免工具拆装设计① 华硕ROG Z890 Extreme主板 Q-DIMM.2扩展卡 免工具拆装设计②　　相信眼尖的XD会发现，此次华硕ROG Maximus Z890 Extreme主板的一体化I/O上盖怎么有个胶条呢？这里来展开说下华硕的贴心设计！总所周知，因为机箱再主板I/O位的风扇会挡住主板这里的一部分，这对需要展示主板设计或屏显内容来说是一个大问题；所以华硕这次将"滑动"设计带到了这块5英寸的LCD屏幕上，从而解决了这一让人恼火的现象。从而让这块5英寸LCD屏幕可以更加清晰直观的展示屏显内容，其可以显示动画、硬件信息，方面用户实时查看及展(zhuang)示(bi)！ 华硕ROG Z890 Extreme主板 外观概览① 华硕ROG Z890 Extreme主板 外观概览② 华硕ROG Z890 Extreme主板 5英寸LCD屏幕 滑动效果展示 华硕ROG Z890 Extreme主板 5英寸LCD屏幕 默认动画展示① 华硕ROG Z890 Extreme主板 5英寸LCD屏幕 默认动画展示②　　华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器，目前是华硕散热器中的旗舰产品；其拥有3.5英寸LCD屏幕(640×480分辨率、60Hz刷新率)，最新的8.5代Asetek水泵方案，并标配了3把新款30mm厚的MF-12S ARGB 磁吸式(连接)风扇，叶片也升级到了9片。配件包含全平台扣具等，而最让人印象深刻的就是新款扣具的变化，全金属背板+冷头偏移扣具，简化安装的同时，也让冷头底板充分接触到CPU的发热源。至于其它方面，就是一些细节设计上的改变了；且售价与目前龙神3同价，真可谓"加倍不加价"的垂直升级！ 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 外包装 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 内包装① 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 内包装② 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 内包装③ 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 30mm MF-12S ARGB 磁吸式(连接)风扇 外观设计① 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 30mm MF-12S ARGB 磁吸式(连接)风扇 外观设计② 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 配件一览　　华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器，其最具标志性的3.5英寸LCD屏幕的磁吸式上盖，拥有更具立体感的全新外观设计，而屏幕内容也可以通过"奥创"软件来自定义设置。水泵还有嵌入式散热风扇，解热效能更甚；加之冷头上盖的镂空设计，可让主板VRM更为凉爽。方形纯铜的吸热底座，预装针对LGA1851优化的全平台扣具，并预涂了硅脂。360规格的铝制冷排，其厚度约30mm，水道/鳍片也十分通透；配合新款轴流风扇，解热效能就不言而喻了。 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 外观设计 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 可分离磁吸式冷头外观设计 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 磁吸式上盖外观设计① 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 磁吸式上盖外观设计② 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 冷头内部设计(内嵌风扇) 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 偏移式(全平台)扣具设计 原理解析 华硕ROG RYUJINⅢ 龙神三代360 ARGB Extreme散热器 冷排/鳍片通透　　测试前，我们先来看下英特尔 酷睿 Ultra 9 285K处理器的实物外观，其虽然采用了全新的Arrow Lake架构，也将针脚加大到LGA1851接口，但其面积还是和Raptor Lake的14900K一样，所以外观上看去就是上盖更修长了、针脚更密集了。但由于其内部模块化的位置变化，散热器解热中心也需要更偏向于CPU模块位置，因此华硕ROG 龙神三代360 ARGB Extreme散热器的偏移扣具设计就起到了解热效率最大化的作用！ 英特尔 酷睿 9系 285K Vs 14900K 外观对比① 英特尔 酷睿 9系 285K Vs 14900K 外观对比② 英特尔 酷睿 Ultra 9 285K 处理器 板皇座驾　　而华硕此次除了对主板的外观及细节设计上有所改变外，还在BIOS上有了些许改变；但初入BIOS界面时并无异样，内存一键超频也支持XMP 8000频率的自动优化(如果手动OC内存，请手动设置相关参数)。但到"工具"栏界面后，你会发现下面多了一个Q-Dashboard选项，其便捷的主板图形化界面，将外接设备和接口状态实时展现(绿色圆点为已接入设备)，点选接入设备后即可看其相关信息，这样高效、直观的界面真是太妙了。 华硕ROG Z890 Extreme主板 BIOS界面① 华硕ROG Z890 Extreme主板 BIOS界面② 华硕ROG Z890 Extreme主板 BIOS Q-Dashboard界面① 华硕ROG Z890 Extreme主板 BIOS Q-Dashboard界面② 华硕ROG Z890 Extreme主板 BIOS Q-Dashboard界面③　　关于效能测试，内存频率8000，本次主要测试Ultra 9 285K的生产力效能，毕竟这款处理器主打生产力至上，我们也来看看这次有着全物理核心(8P+16E)的285K性能究竟如何，有心的XD可以自行对比对标型号。而游戏测试方面，显卡为RTX4090，但主测CPU效能，所以分辨率设为1080P，相关测试成绩如下所示： Ultra 9 285K CPU-Z 测试成绩 AIDIA64 内存 & SuperPi Ultra 9 285K 测试成绩 Ultra 9 285K CINEBENCH R23 测试成绩 Ultra 9 285K CINEBENCH R24 测试成绩 Ultra 9 285K CrossMark 测试成绩 Ultra 9 285K Procyon 测试成绩① Ultra 9 285K Procyon 测试成绩② Ultra 9 285K Procyon 测试成绩③ Ultra 9 285K Procyon 测试成绩④ Ultra 9 285K Procyon 测试成绩⑤ Ultra 9 285K PCMark 10 Extended 测试成绩 Ultra 9 285K PCMark 10 测试成绩 Ultra 9 285K 3DMark CPU Profile 测试成绩 Ultra 9 285K 3DMark Time Spy 测试成绩 Ultra 9 285K 3DMARK Fire Strike Extreme 测试成绩 Ultra 9 285K 3DMARK Fire Strike 测试成绩 地平线：零之曙光 测试成绩 古墓丽影：暗影 测试成绩 赛博朋克2077 测试成绩 黑神话·悟空 测试成绩　　而温度测试中，本次测试为果测平台，Ultra 9 285K处理器为默频默压，室温20°C，风扇PWM。AIDA64单钩FPU模式拷机成绩为：处理器待机35°C、满载84°C；其间CPU的P核能在5.3G左右浮动、E核能在4.6G左右浮动；峰值功耗为330W左右，可见这次Ultra 9 285K处理器的散热表现还是很出色的，而这样的成绩，也得益于大小核的交错排列，让P核的发热量可以平均散开，所以才有了这样的温度表现。 Ultra 9 285K处理器 测试平台 Ultra 9 285K 默频默压 AIDA64(单钩FPU) 满载测试 温度表现　结语　经过此次测试，我们可以看出英特尔 酷睿 Ultra 9 285K处理器在"生产力"方面的效能十分强大；而取消多线程后，仅凭借24个(8P+16E)全物理核心，也获得了非常不错的效能，更提高了能耗比，这也应证了其Arrow Lake架构设计的成功。而华硕ROG Z890 Extreme主板，其有着极为强大的技术规格及用料，可为处理器的性能释放提供最大保障！且全新的外观、易用的设计和极为丰富的扩展，也让玩家看到了一款完美之作。当然，这次评测时间有限，后续我会继续体验并分享华硕ROG Z890 Extreme主板的相关功能给各位。　　好了，本次分享就此结束啦，也先感谢下XD们的关注与支持。惯例楼下回复交流，我会在看到后第一时间答复(*^__^*) 嘻嘻 参与人数 3邪恶指数 +40 收起 理由 TernenceS + 10 hudizhoutube + 10 神月妍妍 + 20 查看全部评分 产品解析 包装盒设计比较朴素。标准的ROG红底银字标题风格，封面仍是翻页设计，但里面并没有透明开窗。附件上，除了光盘外比较有ROG特色的是更厚的说明书、三枚风扇贴、一套线材标签、ROG图案的门把挂卡、以及ASUS只给ROG才提供的电镀版挡板。另外还有四条SATA线和这代ASUS中高阶主板标配SLI桥、机箱接线集线头，以及那个特别不好用的CPU安装框。主板正面全貌，采用全尺寸ATX板型，红色元素相较于过去数年大幅减少。相较于M8H，接口的进一步减少与背部接口处盔甲的减少使得整块主板显得比较素。背部接口配置和M8H完全相同，四个USB2.0、两个USB3.0、一对双形状USB3.1 10Gb/s的USB配置显然谈不上给力。核显输出接口只保留了HDMI和DP这类新时代的数字接口。音频接口采用如今流行的5个3.5mm加一个S/PDIF光纤输出的组合。作为ASUS旗下的具有游戏元素的中高端主板，PS/2接口很幸运地没有被去掉。这个级别的主板也依旧标配了USB Flashback功能。其中网卡仍然是Z170的官配Intel I219V，再配合GameFirst III软件。CPU供电散热片的块头还是比较大的，配合L型的元件排列也是配置了两段散热片，然而热管已经被省去。芯片组散热片看似和M8H相同，实则彩色指示灯已经被去掉了，连纯色灯都不留一个，只剩下金属的ROG LOGO。然而M8R官网页面上那个还闪个不停的图示莫非是在向雷布斯致敬？全套散热片一览。CPU供电部分背面也提供背板散热。移除散热片后正面全貌，灰黑双色插槽既有助于分辨规格简化安装，又不至于破坏整体和谐，但对于习惯了ROG上多年红黑双色插槽的玩家来说似乎产生了一些抵触情绪。和前代一样RANGER的用料相较于HERO也是有所降低。而今年这代不仅仅是电感部分，整版的固态电容也从了105°C下10000小时寿命的型号改成5000小时的型号。尽管这一过剩的地方进行缩减在实际使用中并不会产生什么副作用，但在超长寿命固态电容愈发实惠与普及的今天，在ROG这样具有标志意义的系列中拿这部分开刀的做法未免也太过算计了一些。风扇接口方面和M8H没有太大差别:两个CPU 4pin、四个机箱4pin，一个水冷水泵转用4pin，一组可安装ASUS三风扇扩展板的接口的豪华阵容，还包括一个测温线预留接口。指示灯除了开关自带的几个外依旧包括CPU、内存、显卡、启动盘自检灯以及硬盘读写灯，非常实用。其他接口还包括一个Thunderbolt预留口和一个TPM接口，以及ROG标配的ROG扩展配件接口（需要同时占用紧邻的内置USB2.0），但没有COM和LPT等旧式接口。LGA1151 CPU插座，可支持目前代号Skylake的第六代酷睿、奔腾、赛扬等CPU。10相供电(8相用于CPU核心，2相用于核显)。电感和MOSFET的选择上相比M8H也同样做了简化，当然对于一般的超频来说依旧是绰绰有余了。四条DDR4 DIMM，标准支持最大64GB的DDR4-2133 non-ECC unbuffered内存，支持双通道和XMP。但标称的超频支持度上则只到3400MHz+。一相内存供电。扩展槽方面和M8H无异。三条PCIe x16兼容插槽和三条未封尾的PCIe x1，均为3.0规格，支持NVIDIA SLI和AMD CrossFireX。两条灰色PCIe x16/x8由CPU提供，支持x16+x0和x8+x8，最外侧黑色的PCIe x16最大只支持PCIe 3.0 x4模式，由芯片组提供。存储接口包括两个SATAe（兼容四个SATA 6Gb/s）和两个SATA 6Gb/s，均为Z170原生接口。支持由Intel RST提供的RAID0/1/5/10。一个M.2 32Gb/s SSD接口，由Z170芯片组提供支持PCIe 3.0 x4或SATA模式的SSD。可与SATAe接口以及黑色PCIe x16插槽上的PCIe SSD组建RAID。支持2242/60/80/110四种尺寸规格。Z170芯片组。两位的侦错指示器(Q-Code)和解决内存兼容的MemOK！按钮。并没有直接开启XMP设置的XMP按钮。两组前置USB3.0之一，位于SATA与24pin电源接口之间的传统位置，另一组在主板的另一边(USB2.0与机箱开关接线附近)，每组各支持两个USB3.0，均为Z170原生。板载开关中的常客：开关、复位、CMOS清零。其中开关键还是ROG标配的大号型，但复位键却缩小成很小的一个了。SuperI/O芯片Nuvoton NCT6793D。TPU芯片，提供更丰富的超频、监控项。 "iROG"芯片，提供对ROG扩展附件等支持。这些都是近几年上ROG主板上必不可少的元素。声卡部分和M8H一样采用了SupremeFX 2015方案。采用Realtek ALC1150 Codec，带固定红色隔离灯带。支持广受好评的接入类型检测以及Sonic系列音效软件背部的10Gb/s USB3.1接口由ASMedia ASM1142和EtronTech EJ179V提供。提供KeyBot II键盘强化功能的一颗"iROG"芯片。提供核显输出用HDMI接口的电平切换芯片ASMedia ASM1442K。 ROG MAXIMUS Z790 FORMULA 根据官网规格参数页面，第二个5.0X16的插槽和1号位M.2共用带宽，只能二选一使用 所以存储扩展性是：1*PCIE5.0 M.2+4*PCIE4.0 M.2+1*PCIE4.0*4转U.2+4*SATA 共计10块硬盘对吧? ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II 这块主板是1*PCIE5.0X16+2*PCIE4.0X4设计，官网规格参数页面提示如果1号位插了M.2 SSD则PCIE5.0X16插槽为半速但没提哪个口会被禁用 所以存储扩展性是：1*PCIE5.0 M.2+4*PCIE4.0 M.2+2*PCIE4.0*4转U.2+4*SATA 共计11块硬盘对吧? 我比较看重存储扩展性，现在机器里有4*M.2+2*U.2+4*SATA 10块盘，本来想买新吹雪但发现新吹雪去掉了一条X16插槽，我已有的两个U.2想都用上就得把一个M.2转成U.2。如果上面我计算的对，是不是意味着换Z790-E II能多加一块M.2盘？ 2# 发表于 2023-10-19 11:39 来自手机 | 只看该作者 下载使用手册看里面的挺全，如果没有打客服电话问。 另外pcie5.0的m2都会占用显卡的带宽，而且还会吃4个通道，原来显卡16，用了5.0m2以后都会变成8+4 3# 发表于 2023-10-19 11:48 | 只看该作者 Z790的pcie5.0只能拆8+8。如果5.0的M2一旦用了，拆分的5.0 pcie 8X接口就会作废。反之亦然，还连累显卡只能8X 这也是好多高端板子的弊端，为了增加5.0设备数量增加档次喜欢拆显卡。还不如不拆分实用，z790通道是够的。 10# 发表于 2023-10-23 16:14 | 只看该作者 本帖最后由 Ghoul834629 于 2023-10-23 16:20 编辑 这么说吧 PCIE 5.0　cpu 只有16条 如果你用 5.0的 M.2　那么 会占用4条　CPU 仅剩12条了 但是 由于分配问题　第一条PCIE 接口 就只能运行在X8了 如果你用4.0 固态 就没问题了　pcie 就是X16了 然后 第二个 第五个 M2 都是4.0的速度 走的是 PCH（南桥） 纯血ROG 主板 都有2个PCIE 插槽 可以拆分 变成8+8　如果你要用5.0固态 那么我介意 你买一个 PCIE 5.0的 M.2 转接卡 那么 你就可以插2个5.0 固态了，显卡依旧是X8的速度 序言　　随着Intel 15代处理器的发布,与之配套的主板也接踵而至.其中面向中高端的依旧是Z系列芯片组,本次芯片组的命名依旧顺延其数字,定名为Z890.而作为无人不知的华硕ROG自然而然不会缺席主板首发,为我们带来了纯血ROG中相对来说较为亲民的Maximus Z890 Hero. 产品解析 外包装依旧是熟悉的ROG红黑风格.相比上代几乎毫无区别的附件,包括说明手册,感谢卡,贴纸,钥匙圈.实体附件包括四条SATA线,配套主板接口数量的M.2螺丝与垫片,RGB装饰灯接口转接线,以及无线网卡天线. 内置驱动程序的U盘.风扇支架一枚.可安装在供电散热片顶部以提供散热之用.另一个风扇支架.安装在内存位置前端,可供内存进行散热.附带了一块Hyper M.2的PCIe x16转双M.2 PCIe x4转接卡.单槽标准高度的PCIe设计,采用完整的x16型长度.正面已预装全覆盖散热片,采用和主板统一的斜纹设计风格.背面为无背板设计.两条M.2插槽,双面散热设计并预置导热垫,支持2242/2260/2280/22110尺寸.其中1号插槽支持PCIe 5.0,当使用PCIe5.0 SSD时,2号插槽为关闭不可用状态,且只有安装于主板第二条PCIe 5.0插槽时才可启用5.0速率模式.当安装于芯片组提供的PCIe 4.0插槽时,两个M.2扩展口都可安装PCIe 4.0 x4的SSD.主板正面,依旧是黑色斜纹的设计风格.主板背面配备背板.背板也融入了斜纹风格,并增添了黑色斜纹暗印.右下角硕大的玩家国度LOGO.Hero的徽标.以及ROG的小标语.后方I/O接口,最左侧依旧是标志性的Clear CMOS和BIOS Flashback按钮.其余接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x TypeA), 6个USB 3.2 Gen2(5x TypeA+ 1x TypeC),两个Thunderbolt 4 Type-C(支持核显DP输出),一个核显输出的HDMI 2.1,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 6E无线天线接线端.音频接口仍然是5个3.5mm+1个S/PDIF光纤的组合.L形的供电散热模块依旧延续了上代Z690 Hero的规模.在外观上依旧是ROG近年来采用的层次斜切线设计,可以在保证美观的同时且对散热面积做到一定的提升优化.在背面可以看到其内嵌的热管.I/O上盖也被集成为散热片的一部分,表面的装饰层上则是最大化的镜面效果并标注产品名.镜面之下则依旧是一块装饰屏,默认滚动播放着ROG Hero的霓虹式样动画.可通过Armoury Crate软件定制不同的图案和效果.音频区的装甲,印有SupremeFX字样.音频区装甲背面.主板下半部分的扩展区整体.位于中部的M.2散热片,表面同样做了一点斜切层次处理.位于底部的一整根长条M.2散热片.外观印有ROG的标语以及创始年份.正面散热片较为独立,可以直接卸下,无需先拆除其他位置装甲即可对于拆装更着来说比较友好.三条M.2插槽均预留了背面散热片.中部的M.2插槽,初始位置适配于2280长度,最大可支持22110长度.对于2242与2260的螺丝位,背面散热片上预装的导热垫也已经预切了开孔.底部的两个M.2插槽则最大且默认适配2280长度,背面散热片导热垫同样预置2242以及2260规格的开孔.两块M.2散热装甲背照.中间的大面积芯片组散热模块.由镜面以及斜切元素的银白色ROG LOGO两种拼接风格构成.镜面区域印有"给予那些勇敢冒险者"的英语标语,并在镜面下层隐约显现出一些三角形的设计元素,但很可惜这个区域并不会发光..芯片组散热模块背面.广受好评的显卡快拆按钮继续得以延续.并在结构上做了一定的改良使得体验更加的顺滑.供电散热模块背面,通过导热垫接触MOSFET与电感.融为散热一部分的一体式上盖结构设计,内嵌屏幕与导热垫用于辅助供电散热.主板无遮盖正面全貌.依旧延续的LGA1700 CPU黑化插座.华硕独有的双散热孔位设计依旧得以延续.强化加固的双8pin供电接口.20+1(核心+核显)相CPU供电.每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A).供电主控则为Renesas RAA229131.四条DDR5内存插槽.标称支持最大128GB(4x 32GB)的DDR5-5600内存,超频支持度达到7800MHz+,支持双通道和XMP 3.0.位于旁边的1相内存供电.PCIe扩展插槽提供了两条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16/x8和一条由芯片组提供的PCIe 4.0 x4/x4+4,均为x16全长插槽.第二条PCIe 5.0插槽在使用时需与第一条插槽共享为x8+x8模式,且附件包内的Hyper M.2卡必须装载在第二条上才可以实现单PCIe 5.0 x4 SSD.而芯片组的PCIe 4.0插槽由于芯片组限制只支持x4或是x4+x4.比如Hyper M.2卡这种支持拆分一转二的扩展卡在搭载两个PCIe 4.0的SSD时即可完整享用x4+x4模式.存储方面,中部的M.2_1插槽由CPU提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242,/2260/2280/22110尺寸规格.底部的M.2_2以及M.2_3均由芯片组提供,最大速率PCIe 4.0 x4,支持2242,/2260/2280/22110尺寸规格.其中M.2_3还支持SATA协议SSD.侧边接口包含6组SATA,其中4组为芯片组原生.在其左右两侧则是2组前置USB 3.2 Gen1插口,可提供4个前置USB接口.提供两个额外SATA 6Gb/s的ASMedia ASM1061主控两组前置USB 3.2 Gen1通过ASMedia ASM1074 Hub得到.USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,旁边配备了一个6-pin PCIe电源接口,可以使其支持60W的PD协议快速充电.以及主板底部位置设有2组前置USB2.0接口.位于主板右上角的板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及在超频失败时使用最近一次设置启动的Retry按键.在旁边还设有DEBUG纠错指示器以及四颗自检灯.共四组RGB接口,其一组5V ARGB位于右上角.剩余两组5V ARGB以及一组12V RGB接口为主板底部.顶部四枚风扇接口,包含CPU_FAN风扇,CPU_OPT扩展风扇,AIO_PUMP一体水冷水泵接口,以及CHA_FAN1机箱风扇接口.底部三枚机箱风扇接口,包含CHA_FAN2,CHA_FAN3,CHA_FAN4.以及主板右下角一个水冷套装接口组.三段式的切换开关,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式,方便了众多显卡延长线用户.板载音频区,基于Realtek ALC4080 Codec以及ESS ES9218PQ DAC.Intel Z790芯片组.提供BIOS Flashback功能的专用芯片.以及单BIOS ROM芯片.用于负责灯光控制的AURA芯片.提供运行状态监控等功能的NCT6798D芯片.拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.用于扩展BCLK和PCIe调节的G5独立时钟发生器.Intel I225-V 2.5GbE LAN网卡主控.为雷电4接口提供支持的Intel JHL8540控制器.用于稳定HDMI信号的IT66318FN缓冲器芯片.ASM1543芯片,以实现USB Type-C口正反盲插.全主板数颗用于稳定USB信号的GL9950VE芯片.Wi-Fi网卡为Intel AX211NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3. 本帖最后由 AC♥小武 于 2024-12-21 19:12 编辑　　今天来分享一套近期比较火热的装机方案，一款结构很新颖的大型海景房机箱——HAVN HS 420。HS 420 是一款兼具功能美感和以用户为中心的创新的作品。在保持传统中塔尺寸的同时，采用全新的双腔GPU中心设计，为显卡提供无与伦比的中央气流。HS420专为市场上最强大的风扇和散热器而设计，全机箱11个风扇位均支持最大140mm的风扇安装，同时在其顶部、右侧和底部支持最多 420 毫米散热器。UniSheet 热成型全景玻璃面板设计，使其更平坦且半径更小，以最大限度地减少视觉失真，为玩家呈现完美的海景房展示效果等等......HS 420可谓集外形美观、功能实用，性能强大与市面一众海景房设计优点于一身的创新产品，接下来让我们进入装机环节来一睹风采。 CPU　INTEL Ultra7 265K散热　九州风神 阿萨辛4主板　ROG MAXIMUS Z890 APEX电源　ROG STRIX 1000W GOLD AURA显卡　索泰 RTX 4080 SUPER 月白机箱　HAVN HS420内存　阿斯加特 博拉琪II 8000 32G风扇　TT SWAFAN EX12 ARGB HAVN HS 420是一款兼具功能美感和以用户为中心的全新混合结构机箱，采用中塔尺寸+双仓设计。 机箱顶部为长条形格栅开孔盖板，采用弧形冲压成型并通过精密CNC加工。 机箱IO位于顶部并完美融入到了HS 420顶部侧边的一条格栅开孔内，分别为：3.5mm复合音频接口、USB 3.2 Gen2 Type-C接口、USB 3.2 Gen1 Type-A接口 * 2、开机键。 拥有市面上最强大的散热设计，全机箱提供11个风扇位，且均可安装120/140mm风扇，顶部、侧面和底部均支持420规格冷排，风冷散热器最高支持185mm。 机箱结构一目了然，主板位于左上，显卡位于机箱正中心位置，右侧为多功能位置，可实现硬盘、风扇、冷排以及安装一个便携屏幕。 机箱的创新设计之一，位于机箱尾部提供了上下两个风扇位，实现一种全新的风道结构，后面板底部的附加风扇进气口可将冷空气直接引导至显卡，完美平衡进气和排气。确保最佳性能的同事有助于保持系统更清洁、无尘。 顶盖通过一个手拉绳，即可轻松拆除。 机箱背部设计同样特别出彩，也是个人非常喜欢的设计点，一整个背板进行了全格栅开孔，提供最佳的散热效能同时，工业风格十足。 机箱顶部风扇框架特写，可通过螺丝进行快速拆除，拆下框架方便在机箱外进行冷排与风扇的安装。 90°一体弯折UniSheet 热成型全景玻璃面板，设计得更平坦且半径更小，以最大限度地减少视觉失真，为玩家提供完美的视觉效果。 玻璃支持免螺丝快拆，在机箱上部有做了多处特别设计的滑槽，通过卡扣将玻璃侧板挂住，其它侧板、顶盖和尾板也均为磁吸固定，同样方便拆装。 主板支持最大E-ATX规格，在上方又右侧部署了SimpliCable 布线系统。 HS 420独特的SimpliCable 布线系统，使得线材可轻松穿过并且一字排开，进行整齐地布线，通过巧妙的硅胶直通装置和稳定的夹子实现精确的电缆管理，从而实现完美的整体外观。 3向可调节结构支撑架设计，为各种形状和尺寸的显卡提供了有力支撑。 来到机箱背面，映入眼帘的便是各种颜色的贴条，它是机箱理线引导，为玩家们提供了方便且非常便捷的走线方式引导，让装机难度大大降低。 机箱集成风扇集线器，方便玩家进行统一接驳，减少机箱正面主板面的线材接驳。 机箱底部为全封闭式设计。 主板来自华硕最新旗舰——ROG MAXIMUS Z890 APEX。 全新的APEX主板，采用了全白PCB板加银白色装甲的设计，质感十足十分好看。 主板背面印有刷大的ROG 与 APEX LOGO。 一体式I/O+VRM散热装甲，通过热管连接，更大的散热面积延伸至电感区，为主板提供强大的散热效能。 采用22+1+2+2相供电模组，每个供电模组均随附一个高导磁率铝合金核心电感，额定可处理45安培，且输入与输出过滤均由固态聚合物电容提供，额定可在高运行温度环境下提供数千小时的稳定运行。 LGA 1851插座，INTEL最新ultra200全系列处理器。 两条内存插槽，作为一款专为超频而生的主板，可轻松突破内存高频，同时拥有AEMP3.0、DIMM FIT、DIMM FLEX等多项技术加持下，让超频更为轻松容易，冲击更高频率也更为容易。 主板右上角提供DEBUG数字灯与板载开机键和FLEX KEY。 采用8+8Pin ProCool II 高强度供电接口设计，实用特制接针，确保与EPS 12V电源线连接更充分，降低阻抗，坚固耐用。 主板提供超大M.2与芯片组散热片，有效降低芯片组区域和M.2温度。 全新的M.2快拆装甲设计，加厚的散热片，便捷的拆卸方式，为玩家提供强大的便利性。 M.2硬盘安装也同样进行了重新设计，无需使用螺丝刀，只需要拨开右边的滑轨卡扣，即可进行硬盘拆装。 提供了丰富的扩展支持，高达6个M.2插槽，其中：3个PCIe5.0，1个PCIe4.0，2个PCIe4.0（通过ROG DIMM.2扩展卡）1个USB 20G，1个USB 10G，1个USB 5G前置接口，以及4个SATA硬盘接口，同时可接入一个8PIN供电，为前置接口提供高功率充电输出。 主板底部丰富的接口与功能，为超频提供丰富的功能支持。 主板音频区域特写，采用ALC4080芯片+SAVITECH SV3H712放大器，高品质音频电容。 2 x Thunderbolt™ 4 ports (USB Type-C®)1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)4 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)1 x Realtek 5Gb Ethernet port2 x Gold-plated audio jacks1 x Optical S/PDIF out port1 x BIOS FlashBack™ button 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port 全新设计WIFI7天线，免去螺丝，直插使用更方便。 DIMM.2扩展卡，正反均为PCIe4.0x4，支持长度为2230/2242/2260/2280/22110。 通过主板DIMM插槽接在主板上，位于内存插槽旁边。 主板提供了用于内存超频辅助散热的风扇，通过两颗螺丝进行快速安装部署。 包装盒设计依然是阿斯加特家族式包装设计，经典且独具一格的磁吸开合式设计，盒子正面拥有精美的诗歌之神博拉琪刻画，背面是产品的关键信息介绍以及产品标签。 延续一代经典的镜面电镀外观搭配定制的古铜色铭牌，为玩家呈现顶级的喷砂与镜面双重质感感受。 the god of poetry.wisdom and eloquence. 金属喷砂质感的边框加镜面处理，不仅内存颜值在线，同时通过镜面倒影，给予了一种无限镜的特别效果。 内存采用正反一致设计，采用了特挑高规格海力士A-Die颗粒，为玩家们带来了8000的高频与C36的超低时序，最新的制程工艺具有功耗低性能强的特点，并且采用10层PCB板，可以带来更好的电气性能，提升内存的耐压性，同时减少电气信号之间的干扰，对内存的稳定运行很有帮助，超频潜力足以满足追求高性能的用户需求，并且产品还支持Intel XMP3.0和AMD EXPO，无需用户反复调试内存参数，一键就可轻松超频，不仅颜值能打性能也很强劲。 内存顶部为贯穿整条导光设计，并且在两侧做了分切处理，呈现三段式结构。 内存金手指特写。 内存尺寸为：133.4x45.6x8mm，高度仅为45.6mm非常友好，兼容市面大多数机箱与散热器，金属喷砂质感边框，侧边有一颗内六角螺丝进行固定，质感十足。 阿萨辛4配件一览，多平台易安装扣具，附送高品质螺丝刀方便快捷安装，标配DM9高性能有机硅导热硅脂。 阿萨辛4散热器三维尺寸为:144mm*147mm*164mm（WxDxH），重量为1575g。 位于顶部还有一个双模运行的开关，可在静音模式和性能模式之间相互切换。在性能模式下，转速在500至1700 RPM±10%之间，最大风量分别为58.06 CFM和79.1 CFM，最大风压分别为2.44 mmAq和2.1 mmAq，噪音值≤29.3 dBA运行时非常安静。在静音模式下，转速在500至1350 RPM±10%之间，最大风量分别为46,75 CFM和63.76 CFM，最大风压分别为1.58 mmAq和1.35 mmAq，噪音值≤22.6 dBA。 顶部有一个九州风神LOGO，波动顶部开关切换模式，LOGO灯光亮度会随之变化。 阿萨辛4散热器顶部非常平整，位于中心部分有一圈金属的网罩，采用磁吸设计，只需轻轻一抠，即可掀开网罩。 内部安装的另一枚14mm风扇，采用卡扣快拆设计，轻轻捏合，即可向外抽出风扇本体，阿萨辛4采用了一枚140mm正叶外加一枚120mm反叶风扇组合。 底座采用精加工微凸铜底座，在压力扣具的作用下能更加紧密的贴合CPU，采用双向恒定热平衡7热管，解热功耗高达250W。 显卡来自索泰RTX 4080SUPER，显卡外观设计曲线优雅简洁，珠圆玉润，心中的白月光，美感十足。 采用自家IceStorm2.0散热系统，散热马甲正面采用三颗9cm仿生盾鳞2.0双滚珠轴承风扇，风量、风压得到全面提升，轻松吹透九根热管+大面积均热板+高密度散热鳍片带来的滚滚热量。 显卡侧面拥有SPECTRA灯效系统，贯穿显卡侧面的ARGB虹桥LOGO灯带，支持1600万色调色以及多种灯效模式。 高密度散热鳍片，加厚加高的镀镍散热鳍片模组，大幅提升了散热面积和导热能力。 IO挡板刻印有索泰GAMING LOGO，挡板为双槽设计，配备四个显示输出口：一个HDMI 2.1，三个DP1.4a，支持 8K@60 输出。最高数字分辨率和刷新率 4K 240Hz 或 DSC技术支持，显示8K 60Hz HDR效果。同时支持4个显示器，支持HDCP 2.3，支持HDR，支持动态刷新率等。 背板采用流线设计，线条优美，并在尾部做了开孔，有助于气流吹透散热鳍片。 采用英伟达 12VHPWR供电接口，只需一根线即可为其供电，相比过去的3x8Pin，节省了大量空间。 风扇来自TT 曜影 SWAFAN EX14CM ARGB磁吸风扇。 产品本体以及配件，风扇可以拆卸，同时提供一套替换式反叶风扇，相当于一套风扇，同时拥有了正叶、反叶，根据玩家机箱需求，自行切换，极大方便且性价比十足！ 拥有20颗可单独控制的LED灯珠，外环14个LED灯，内环6个LED灯，双层独立的LED导光圈，可通过5V主板灯效软件对其进行精准灯光效果控制。 采用磁吸式串联设计，便捷的连接线材，优异的散热效能，炫酷ARGB灯效。 ROG STRIX 1000W GOLD AURA 电源来自华硕 ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源，这款电源定位为次旗舰产品，外包装也是典型的吹雪风格。这款电源通过了80 PLUS金牌认证，即使在满足状态下，转化效率依旧可达89%以上，日常50%负载状态下，转化效率更是高达91.5%，超越80 PLUS金牌认证标准，华硕也为这款电源提供了长达10年的质保售后服务。 配件方面也是满满的吹雪元素。模组线采用16AWG线径及高规格合金端子，从容应对大功率传输场合，压纹线配色同样采用吹雪元素，线材质感但细腻而且柔软，装机过程中降低了理线难度，也提升了整体美观程度，同时也为用户省去了单独定制线材的成本。 电源三维尺寸为：180*150*86MM，电源侧面的败家之眼还支持RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术。 ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源搭载了ROG定制散热模组，具备更大的散热面积，搭配135mm双滚珠轴承轴流风扇和铝制外壳设计，能够提供极为出色的散热实力，这款电源还支持低噪音和0dB模式，电源负载低于60%时，风扇即可自动停转。 ROG STRIX 1000W AURA吹雪电源额定功率为1000W，通过了80Plus金牌认证，采用单路+12V输出设计，其中+12V最大额定电流为83.3A，相当于1000W输出功率，+5V与+3.3V最大额定电流均为20A，联合输出功率则为110W，支持100V至240V输入电压。 电源采用全模组接口设计，不仅配备了原生16 Pin PCIe 5.0供电接口，还支持新一代ATX 3.0供电标准，可承受2倍整体峰值功耗或3倍显卡峰值功耗，完全可满足新一代CPU和显卡的供电需求，也确保主机整体安全稳定的运行。 AC输入接口有独立开关以及风扇0 dB FAN智能停转按钮，可一键切换为常规温控模式。 参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由 youzhusky + 20 查看全部评分 序言　　ROG玩家国度在Z690上的E-ATX大板真旗舰, 也即ROG Extreme系列的款式, 在Intel第12代Core与Z690平台发布之初就以普通版和水冷版的双版本同步上市发售, 此前CHH评测室已经展示了水冷版(ROG Maximus Z690 Extreme Glacial)的装机实例视频(．而本篇评测的主角则是适用性更宽泛的普通版本: ROG Maximus Z690 Extreme.